**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OFERTA**

Do

**Politechnika Warszawska**

**Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych**

**ul. Nowowiejska 15/19**

**00-665 Warszawa**

Nawiązując do zapytania ofertowego na **Dostawę modułów zawierających układ programowalny Xilinx z rodziny Zynq Ultrascale+, pamięć RAM i układy peryferyjne, typ Enclustra ME-XU1-6EG-1I-D11E-R4.1**  zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr **WEiTI/2/11.5.1/ZP/2021/1034**

MY NIŻEJ PODPISANI /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
2. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia:

wartość netto: **…………………….….PLN**

(słownie: ………….………………………………………………………………………………………………..…………… )

**plus należny podatek VAT**………………… co daję cenę brutto ……………………………… **PLN  
(**słownie: ………………………………………………………………………………………..………………..………………)

1. Termin wykonania:

**15 szt. nie później niż do 30.04.2022;**

**35 szt. nie później niż do 01.08.2022.**

1. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **OFERTĘ** niniejszą wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa modułów zawierających układ programowalny Xilinx z rodziny Zynq Ultrascale+, pamięć RAM i układy peryferyjne, typ Enclustra ME-XU1-6EG-1I-D11E-R4.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacje ogólne** | | | | |
| L.p. | Informacja |  | Wartość oferowane przez Wykonawcę |
| 1. | Nazwa elementu | Moduł SoM z układem SoC Xilinx Zynq Ultrascale+  Enclustra ME-XU1-6EG-1I-D11E-R4.1 |  |
| 2. | Opis ogólny | Moduł zawierający układ programowalny Xilinix z rodziny Zynq Ultrascale+ ze zintegrowanym procesorem w architekturze ARM, pamięcią RAM i układami peryferyjnymi |  |
| 3. | Liczba sztuk | 50 (pięćdziesiąt) |  |
| **Opis techniczny** | | |  | |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość wymagana przez Zamawiającego | Wartość oferowane przez Wykonawcę |
| 1. | Układ programowalny w architekturze SoC | Układ SoC XCZU6EG-1FFVC900I posiadający architekturę Xilinx Zynq Ultrascale+ wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53 oraz 2 rdzeniowy koprocesor czasu rzeczywistego w architekturze ARM Cortex-A5 oraz 469446 komórek logicznych |  |
| 2. | Pamięć RAM | 2GB z kontrolą parzystości ECC |  |
| 3. | Rozmiar pamięci FLASH eMMC | 16GB |  |
| 4 | Ilość linii transceivera MGT | 12 |  |
| 5 | Ilość transceiverów Gigabit Ethernet | 2 |  |
| 6 | Transceivery USB3.0 | 2 |  |
| 7 | Transceivery USB2.0 | 2 z funkcją host/host-device |  |
| 8 | Linie PCIe | Gen2 |  |
| 9 | Wersja modułu | Nie starsza niż 4 |  |
| 10 | Zasilanie | W zakresie minimalnym od 5 do 15V, zintegrowany układ zarządzania zasilaniem generujący niezbędne pozostałe napięcia zasilania |  |
| 11 | Zakres temperatur pracy | Min. -40 .. +85 st.C |  |
| 12 | Złącza modułu | 3 złącza typu Hirose FX10 168 pin |  |
| 13 | **Termin dostawy**  **(kryterium punktowane)**  1 – 9 maja 2022 – 0 pkt.  30 kwietnia 2022 i wcześniej – 30 pkt. | Nie później niż 9.05.2022 |  |
| 14 | **Gwarancja** | Min. 12 miesięcy |  |

**Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | **Pozostałe wymagania, wspólne dla wszystkich części** | ***Oferowane przez wykonawcę*** |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania:  **15 szt. nie później niż do 30.04.2022;**  **35 szt. nie później niż do 01.08.2022.** | TAK / NIE\*\*\* |
| 2. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE\*\*\* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE\*\*\* |
| 4. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK / NIE\*\*\* |
| 5. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE\*\*\* |
| 6. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych pok. 422 | TAK / NIE\*\*\* |

1. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszego formularza oferty są:
2. Wzór umowy
3. Dokument rejestrowy
4. Pełnomocnictwo ( jesli jest wymagane)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)